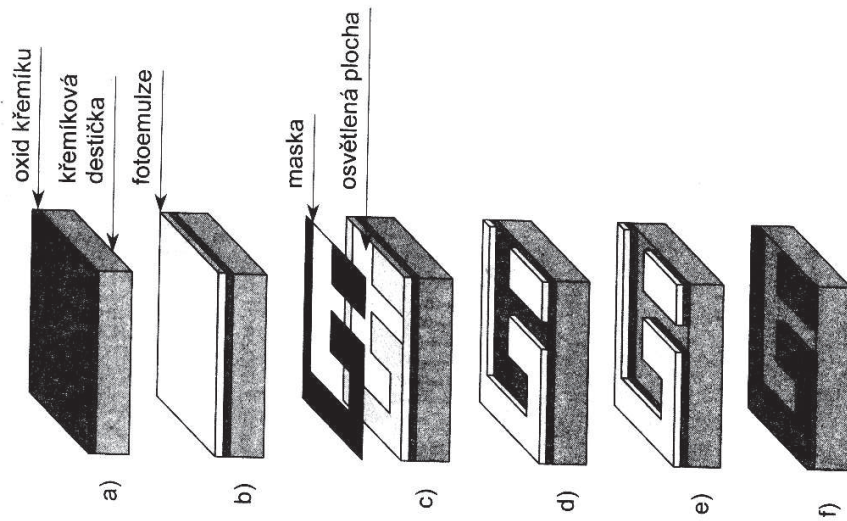


Úprava celé destičky (plátku) probíhá fotografickou cestou, jak je znázorněno v následujících obrázcích (obr. 4.47):

- Vytvoření vrstvy oxidu křemičitého na povrchu křemíkové destičky.
- Nanesení vrstvy citlivé na světlo (fotoemulze).
- Osvětlení fotoemulze přes masku.
- Vyvolání a následné rozpuštění vyvolané fotoemulze.
- Leptání oxidu křemíku.
- Odstranění zbylé (nevývolané) fotoemulze.

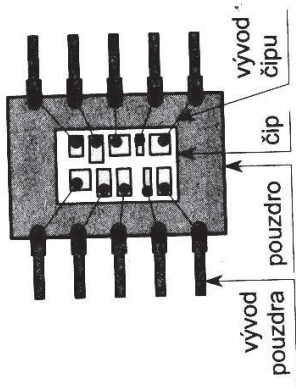


Obr. 4.47 Fotografické zpracování křemíkové destičky

Na destičce s takto vytvořenými cestami se tzv. *fotolitografickou* cestou v odleptaných místech vytvoří difúzí donorů a akceptorů polovodiče typu P a N.

Destička se po proměření funkčnosti rozřeže na jednotlivé čipy a ty se nalepí na nosné podložky.

Vývody čipu se propojí zlatými, měděnými nebo hliníkovými drátky k vývodům pouzdra (obr. 4.48).

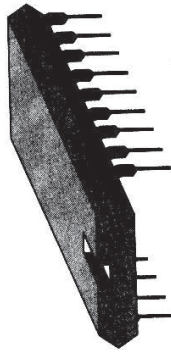


Obr. 4.48 Propojení čipu

ZAPOUZDŘENÍ

Celek se hermeticky umístí do ochranného pouzdra (zapouzdří).

Pouzdra mohou být buď kovová jako u tranzistorů nebo umělohmotná typu DIL (dual-in-line), viz obr. 4.49.



Obr. 4.49 Pouzdro typu DIL

Kontrolní otázky – test T3

- Co je to tranzistor?
- Co znamená tranzistor bipolární?
- Kolik přechodů a kolik elektrod má tranzistor typu NPN?
- Jak se liší emitorový proud od kolektorového?
- Dle obrázky zapojený tranzistor vede či nevede?

